**보도자료**

****

**삼텍, AcceleRate® HP 고성능 어레이 출시**

새로운 PICMG COM-HPC® 인터커넥트 솔루션의 기초

202 칠7월 XX일 – 800백만 달러 규모의 광범위한 전자 인터커넥트 솔루션 제품 전문 개발 기업인 삼텍(Samtec Inc.)는 차세대 AcceleRate HP 고성능 어레이를 출시했다고 밝혔다. AcceleRate HP는 초소형 풋프린트에서 112Gbps PAM4의 탁월한 성능을 지원한다.

AcceleRate HP 고성능 어레이는 접지 및 라우팅 유연성을 극대화하는 오픈 핀 필드 어레이를 갖추고 있다. 시스템 설계자는 동일한 인터커넥트를 통해 고성능 차동 쌍(differential-pairs), 단일 종단 신호(single-ended signal) 및 고전류 전압 레일을 라우팅할 수 있다.

또한 2.2/2.4/2.2mm 행 피치(row pitch)는 차동 신호의 라우팅을 용이하게 한다. 크로스토크(누화)는 공간이 늘어나고 차동 신호 주변에 접지 비아를 더 추가할 수 있는 기능으로 개선된다.

삼텍의 마이클 분(Michael Boone) 고속 보드 대 보드 제품 담당 매니저는 "새로운 AcceleRate HP 고성능 어레이는 소형 폼 팩터에서 고속 112Gbps PAM4 성능의 표준을 정립했다"라며, "AI 가속기, ASIC 에뮬레이터 및 차세대 에지 컴퓨팅 플랫폼과 같이 빠르게 성장하는 애플리케이션은 이러한 성능 특징을 통해 이점을 누릴 수 있을 것”이라고 말했다.

주요 AcceleRate HP 고성능 어레이 특징:

• 고밀도 0.635 mm 피치
• 로우프로파일 5mm 및 최대 10mm 스택 높이
• 최대 총 400개의 핀 사용 가능
• 1,000개 이상의 핀에 대한 로드맵
• PCIe® 5.0 및 100GbE와 호환되는 데이터 전송 속도
• 간편한 조립 및 자가 정렬을 위한 BGA 종단

AcceleRate HP 고성능 어레이 상세 정보: [www.samtec.com/accelerateHP](http://www.samtec.com/accelerateHP).

**PICMG COM-HPC 커넥터**
새로운 PICMG COM-HPC 스펙은 삼텍의 AcceleRate HP 고성능 어레이에 기반한 400핀 커넥터 쌍을 채택하여 시스템 및 인터페이스 유연성을 제공한다. Samtec COM-HPC 커넥터는 캐리어를 서버 및 클라이언트 모듈에 연결한다. PCIe 5.0 및 최대 100GbE와 같은 기존 인터페이스와 향후 인터페이스를 지원한다. 커넥터 쌍은 5mm 또는 10mm 스택 높이를 지원한다.

삼텍의 COM-HPC 커넥터 관련 상세 정보:

브로셔 다운로드: [COM-HPCInterconnect Solutions eBrochure](https://suddendocs.samtec.com/ebrochures/samtec-com-hpc-ebrochure.pdf)

웹사이트: [www.samtec.com/COMHPC](http://www.samtec.com/COMHPC)

문의: COMHPC@samtec.com.

**삼텍(Samtec, Inc.) 회사 소개**

1976년에 설립된 삼텍은 고속 보드대보드(board-to-board), 고속 케이블, 미드 보드 및 패널 광학, 정밀 RF, 유연한 스태킹 및 마이크로/러기드 부품 및 케이블을 포함한 다양한 전자 인터커넥트 솔루션 라인을 제공하는 8억달러 규모의 비상장 제조기업이다. 삼텍은 전세계 40여곳의 지사 운영과 125개국에서의 제품 판매를 통해 뛰어난 고객 서비스를 실천하며 글로벌 시장에서의 입지를 다지고 있다.

상세 정보는 <http://www.samtec.com>참조.

**Samtec, Inc. 문의**

**P.O. Box 1147**

**New Albany, IN 47151-1147**

**USA**

**Phone: 1-800-SAMTEC-9 (800-726-8329)**

www.samtec.com

**보도자료 문의:**

Matt Burns

matthew.burns@samtec.com

812-944-6733